

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



上海復旦微電子集團股份有限公司

Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號: 1385)

海外監管公告

本公告乃上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條的規定刊發。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《向不特定對象發行 A 股可轉換公司債券之上市保薦書》，僅供參閱。

承董事會命
上海復旦微電子集團股份有限公司
主席
蔣國興

中國，上海，2024 年 4 月 8 日

於本公告日期，本公司之執行董事為蔣國興先生、施雷先生及俞軍先生；非執行董事為章倩苓女士、吳平先生及孫崢先生；獨立非執行董事為曹鍾勇先生、蔡敏勇先生、王頻先生及鄒甫文女士。

*僅供識別

中信建投证券股份有限公司

关于

**上海复旦微电子集团股份有限公司
向不特定对象发行 A 股可转换公司债券
之**

上市保荐书

保荐人



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

二〇二四年四月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人赵凤滨、逯金才已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

释 义	3
一、发行人基本情况	5
二、发行人本次发行情况	17
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、电话和其他通讯方式	18
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明	21
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项	22
六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明	23
七、保荐人关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程	24
八、持续督导期间的工作安排	25
九、保荐人认为应当说明的其他事项	26
十、保荐人关于本项目的推荐结论	26

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

一、一般释义		
保荐人、主承销商、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
发行人、复旦微、复旦微电、公司	指	上海复旦微电子集团股份有限公司，原名上海复旦微电子股份有限公司
报告期、报告期内	指	2021年、2022年和 2023年
报告期各期末	指	2021年12月31日、2022年12月31日和 2023年12月31日
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
A股	指	发行人股本中每股面值人民币0.10元并在上交所科创板上市的A股普通股
H股	指	发行人股本中每股面值人民币0.10元的境外上市外资股，其以外币认购及买卖，并于香港联交所上市
元、万元、亿元	指	除非特指，均为人民币元、万元、亿元
可转债	指	可转换为公司A股股票的可转换公司债券
本次发行	指	上海复旦微电子集团股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券
二、专业释义		
IC、集成电路、芯片	指	Integrated Circuit 的缩写，是一种通过一定工艺把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型电子器件或部件。当今半导体工业大多数应用的是基于硅的集成电路
晶圆	指	经过特定工艺加工，具备特定电路功能的硅半导体集成电路圆片，经切割、封装等工艺后可制作成IC成品
封装	指	芯片安装、固定、密封的工艺过程。发挥着实现芯片电路管脚与外部电路的连接，并防止外界杂质腐蚀芯片电路的作用
高可靠、高可靠产品	指	运用于各种特定环境条件中且在使用生命周期内具有稳定连贯功能和性能的集成电路产品

RFID	指	即射频识别（Radio Frequency Identification），其原理为阅读器与标签之间进行非接触式数据通信，以达到识别目标的目的
MCU	指	微控制单元（Microcontroller Unit），是把中央处理器的频率与规格做适当缩减，并将内存、计数器、USB、A/D 转换、UART、PLC、DMA 等周边接口，甚至 LCD 驱动电路都整合在单一芯片上，形成芯片级的计算机，为不同的应用场合做不同组合控制
FPGA	指	现场可编程门阵列（Field-Programmable Gate Array），是在 PAL、GAL、CPLD 等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路（ASIC）领域中的一种半定制电路而出现的，既解决了定制电路的不足，又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
EEPROM	指	带电可擦可编程只读存储器（Electrically Erasable Programmable read only memory），是一种掉电后数据不丢失的存储芯片。EEPROM 可以在电脑上或专用设备上擦除已有信息，重新编程。一般用在即插即用
闪存	指	Flash Memory，全称为快闪存储器，是一种非挥发（即断电后存储信息不会丢失）半导体存储芯片，具备反复读取、擦除、写入的技术属性，属于存储器中的大类产品。相对于硬盘等机械磁盘，具备读取速度快、功耗低、抗震性强、体积小的应用优势
NAND Flash	指	数据型闪存芯片，主要的非挥发闪存技术之一，可以实现大容量存储、高写入和擦除速度，是海量数据的核心，多应用于大容量数据存储
SLC NAND Flash	指	SLC(Single Level Cell) NAND Flash 为单层式存储 NAND Flash，每个存储单元仅储存一位数据，相较其他类型 NAND Flash 存储单元（MLC/TLC），其读写算法更简单、速度更快、数据可靠性更高
NOR Flash	指	主要用来存储代码及部分数据，具备随机存储、可靠性强、读取速度快、可执行代码等特性，在中低容量应用时具备性能和成本上的优势
物联网、IoT	指	Internet of Things，指物物相连的物联网。通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程，采集各种需要的信息，通过各类可能的网络接入，实现物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理
SoC	指	片上系统（System-on-Chip），意指一个有专用目标的集成电路，其中包含完整系统并有嵌入软件的全部内容

注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

公司名称:	上海复旦微电子集团股份有限公司
注册地址:	上海市邯郸路 220 号
成立时间:	1998 年 7 月 10 日
A 股上市时间:	2021 年 8 月 4 日
H 股上市时间:	2000 年 8 月 4 日
注册资本:	8,190.604 万元人民币
A 股股票上市地:	上海证券交易所
H 股股票上市地:	香港联合交易所
A 股股票简称:	复旦微电
H 股股票简称:	上海复旦
A 股股票代码:	688385.SH
H 股股票代码:	01385.HK
法定代表人:	蒋国兴
董事会秘书:	方静
联系电话:	021-65659109
互联网地址:	http://www.fmsh.com/
主营业务:	复旦微电是一家从事超大规模集成电路的设计、开发、测试，并为客户提供系统解决方案的专业公司。公司目前已建立健全安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片、FPGA 芯片和集成电路测试服务等产品线，产品广泛应用于金融、社保、防伪溯源、网络通讯、家电设备、汽车电子、工业控制、信号处理、数据中心、人工智能等众多领域。
本次证券发行的类型:	向不特定对象发行 A 股可转债

（二）发行人主营业务、核心技术、研发水平

1、主营业务情况

复旦微电是一家从事超大规模集成电路的设计、开发、测试，并为客户提供系统解决方案的专业公司。公司目前已建立健全安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片、FPGA 及其他芯片、集成电路测试服务等产品线，产品广泛应用于金融、社保、防伪溯源、网络通讯、家电设备、汽车电子、工业控制、信号处理、数据中心、人工智能等众多领域。

2、核心技术、研发水平情况

公司自成立以来，持续专注于集成电路设计与研发，经过二十余年的发展，积累了丰富的行业经验与技术。公司现阶段所掌握的核心技术如下：

序号	核心技术名称	主要用途	技术来源	应用产品	专利号/ 非专利技术	
安全与识别芯片						
1	非接触读写器载波的波形和场强控制	修正调制波形，可以同时满足 EMV 检测相关要求和良好的射频匹配	自主研发	安全与识别非接触读写器	非专利技术	
2	低功耗外部卡片检测功能	以低功耗方式进行外部卡片进场检测，满足低功耗手持式读写器的应用需求	自主研发	安全与识别非接触读写器	非专利技术	
3	公钥密码算法安全防护技术	模幂运算的方法和装置	用于减少模幂运算装置的功耗，能够有效的防止功耗分析	自主研发	130nm 工艺平台上的双界面 CPU 卡芯片	2013105179422
		椭圆曲线密码点乘运算的方法和装置	用于芯片上减少点乘运算装置的功耗，提高 RAM 的利用率，并能够有效的防止功耗分析	自主研发	130nm 工艺平台上的双界面 CPU 卡芯片	2013105179564
		数据的防攻击方法及装置、RSA 模幂运算方法、装置和电路	用于芯片上减小执行不同的数据位的值而引起功耗差异，提高 RSA 算法的安全性	自主研发	130nm 工艺平台上的双界面 CPU 卡芯片	2013105179386
		一种 RSA 模幂运算方法和装置	用于芯片上优化 RSA 模幂运算的安全防护方案，提高 RSA 加密处理的效率	自主研发	55nm 工艺平台上的双界面 CPU 卡芯片及安全控制器芯片	2013106087555
		一种基于蒙哥马利模乘的数据处理方法和装置	用于芯片上大整数乘法的硬件实现方案，提高了 RSA 的运算速度	自主研发	55nm 工艺平台上的双界面 CPU 卡芯片及安全控制器芯片	2013107543697
		一种基于模幂运算的数据处理方法和装置	用于芯片上利用模幂计算 $RR \bmod N$ ，提高了数据处理效率	自主研发	55nm 工艺平台上的双界面 CPU 卡芯片及安全控制器芯片	2013107545122
		基于蒙哥马利模乘的数据处理方法、模乘运算方法及装置	用于芯片上任意长度的蒙哥马利模乘运算优化方案，提高了运算效率	自主研发	55nm 工艺平台上的双界面 CPU 卡芯片及安全控制器芯片	2015107530056

序号	核心技术名称		主要用途	技术来源	应用产品	专利号/ 非专利技术
		基于蒙哥马利模乘的数据处理方法、模乘运算方法和装置	用于芯片上任意长度的蒙哥马利模乘运算优化方案，提高了运算效率	自主研发	55nm 工艺平台上的双界面 CPU 卡芯片及安全控制器芯片	2015107530198
4	安全加密方法和装置、安全解密方法和装置		用于芯片上加密算法的验证方案，防止错误注入攻击	自主研发	55nm 工艺平台上的双界面 CPU 卡芯片及安全控制器芯片	2013107545137
5	地址总线中地址数据转换方法及装置		用于芯片上的地址扰乱加密算法，有效降低了功耗	自主研发	55nm 工艺平台上的双界面 CPU 卡芯片及安全控制器芯片	201510078896X
6	PUF (Physical Unclonable Function) 设计技术		利用了 PUF 的物理唯一性和随机性，提升内嵌算法的抗攻击性能，是性价比较高的防伪溯源方案	自主研发	高频防伪 RFID	2016104142301 2016104105779
7	高精度温度传感器设计技术		用于温度传感系列产品中	自主研发	双频 RFID 测温芯片，高频 RFID 测温芯片，超高频 RFID 测温芯片，温度传感芯片	201010568424X
非挥发存储器						
8	适用于低电压数据写入的 EEPROM 擦写高压转换控制缓存器		提升非挥发存储器高压转换缓冲器的低电压性能，使得存储器可以适应超低工作电压需求	自主研发	应用于非挥发存储器	2007100474614
9	电平转换与非电路		用于高可靠 NOR 存储器阵列译码驱动的设计，可降低对工艺的敏感度，提升低压低功耗性能，整合译码与驱动，降低成本。	自主研发	应用于非挥发存储器	2010102056056
10	用于非易失性存储器的读出放大电路及存储器		读出放大电路可以提高读取存储器时的数据读出速度并且，并延长存储器的使用寿命	自主研发	应用于非挥发存储器	2012101288676

序号	核心技术名称	主要用途	技术来源	应用产品	专利号/ 非专利技术
11	存储器电路	用于电荷泵的钳位电路，可同时保证存储单元的阈值窗口的稳定性、存储单元的可靠性和高压电路中晶体管的可靠性，能够在工作温度范围内实现恒定的钳位电压	自主研发	应用于非挥发存储器	2011104576990
12	具有存储功能的器件	应用于接触/非接触双界面非挥发存储器，可实现对存储器中所存储的不同数据格式的数据进行同时访问	自主研发	应用于非挥发存储器	2014100426697
13	射频标签、对射频标签进行访问的方法及电子系统	一种射频标签、对射频标签进行访问的方法及电子系统，用于电子系统中增强射频标签的交互性能。	自主研发	应用于双接口非挥发存储器	2014100423256
14	电子器件及对电子器件进行访问的方法	一种电子器件及对电子器件进行访问的方法，解决现有技术中电子器件内标签数据与设备信息的配对错误问题	自主研发	应用于非挥发存储器	2014100424723
15	用于电可擦写只读存储器的读出电路和读出方法	一种用于电可擦写只读存储器的读出电路和读出方法，非挥发存储器读出技术。	自主研发	应用于非挥发存储器	2010105418434
16	一种用于检测存储器译码电路的测试图形的生成方法	非挥发存储器测试方法	自主研发	应用于非挥发存储器	2011101383426
17	快闪存储器的擦除方法及快闪存储器	非挥发存储器结构设计	自主研发	应用于非挥发存储器	非专利技术
智能电表芯片					
18	多电源域电源门控和状态保持技术	降低芯片待机功耗，大幅延长系统上电池或超级电容的寿命	自主研发	智能电表主控芯片、低功耗 MCU 芯片	非专利技术
19	超低功耗基准源和稳压器	降低芯片待机功耗	自主研发	智能电表主控芯片、低功耗 MCU 芯片	非专利技术
20	低功耗 SAR-ADC 技术	低功耗的实现高精度高速 AD 采样	自主研发	智能电表主控芯片、低功耗 MCU 芯片	非专利技术

序号	核心技术名称	主要用途	技术来源	应用产品	专利号/ 非专利技术
21	高可靠上电复位	提高芯片可靠性	自主研发	智能电表主控芯片、低功耗 MCU 芯片	2011102476729
22	抗 EMC 干扰技术	提高芯片在恶劣 EMC 环境下长期运行的可靠性	自主研发	智能电表主控芯片、低功耗 MCU 芯片	非专利技术
23	高性能数字滤波技术	实现高效可编程数字信号处理	自主研发	电力线载波通信芯片	2013202248479

FPGA 芯片

24	FPGA 电路架 构及模 块技术	一种无线可编程系统	通过无线可编程的 FPGA 或可编程融合芯片	自主研发	FPGA 及可编程融合芯片	非专利技术
		可编程连接点	应用于可编程 FPGA 或可编程融合芯片关键开关的新技术	自主研发	FPGA 及可编程融合芯片	非专利技术
		可编程芯片电路	工作模式可以动态调节的新型可编程 FPGA 或可编程融合芯片	自主研发	FPGA 及可编程融合芯片	2017110671345 2017110671330
		一种含双通道压控振荡器的锁相环电路	提出了一种可应用于 FPGA 的锁相环电路结构	自主研发	FPGA 及可编程融合芯片	2017101182087
		一种通用的高速串行差分信号分路电路及方法	提出了一种可应用于 FPGA 或者可编程融合芯片的差分电路结构	自主研发	FPGA 及可编程融合芯片	2019106546943
		一种耐压亚阈值 CMOS 基准源	提出了一种可应用于 FPGA 或者可编程融合芯片的基准源电路结构	自主研发	FPGA 及可编程融合芯片	2019104994146
		接口电路	提出了一种可应用于 FPGA 或者可编程融合芯片的接口电路结构	自主研发	FPGA 及可编程融合芯片	2016110892146
		输出电路	提出了一种可应用于 FPGA 或者可编程融合芯片的输出电路结构	自主研发	FPGA 及可编程融合芯片	2016110891711
		电平转换电路	提出了一种可应用于 FPGA 或者可编程融合芯片的电平转换电路结构	自主研发	FPGA 及可编程融合芯片	2017101199209
25	FPGA 测试技 术	一种 FPGA 测试用的多工位快速配置装置及其配置方法	用于提高 FPGA 测试时提高配置效率的方法	自主研发	FPGA 及可编程融合芯片	非专利技术

序号	核心技术名称		主要用途	技术来源	应用产品	专利号/ 非专利技术
		现场可编程门阵列芯片中 DSP 单元的测试系统	通过提高 DSP 测试时的频率, 来提高测试效率的方法	自主研发	FPGA 及可编程融合芯片	非专利技术
		一种测试 FPGA 芯片中信号传输延时的方法	提出了一种关于 FPGA 芯片的传输延迟的测试技术	自主研发	FPGA 及可编程融合芯片	2019102923432
		一种可编程电路的模块测试系统	在尽可能少的增加硬件结构的情况下, 降低模块测试设计的复杂度, 提高测试覆盖率的方法	自主研发	FPGA 及可编程融合芯片	201611256917.3
		一种 FPGA 中双端口 SRAM 阵列的内建自测和修复系统及其方法	采用内建自测的方式对 SRAM 进行测试, 从而大幅提升测试效率的方法	自主研发	FPGA 及可编程融合芯片	2017100997659
26	高速串并转换电路设计	数据时钟恢复技术	高速高通道损耗数据传输链路中时钟恢复	自主研发	FPGA 芯片	非专利技术
		高速低抖动时钟产生技术	为高速数据传输链路提供高速低抖动时钟	自主研发	FPGA 芯片	非专利技术
		电感峰值化技术	增加数据传输通路带宽, 提高传输速度	自主研发	FPGA 芯片	非专利技术
		宽范围发送预加重技术	补偿通道损耗, 提高数据传输能力	自主研发	FPGA 芯片	非专利技术
		自适应通道反射消除技术	自适应检测通道反射较大位置(时间)并予以消除, 提高过信道能力	自主研发	FPGA 芯片	非专利技术
		高鲁棒性接收端内部信号眼图检测技术	检测接收端内部信号眼图, 判读信号恢复质量	自主研发	FPGA 芯片	非专利技术
		利用锁存器实现跨时钟域信号传输的系统	实现信号的跨时钟域的稳定传输	自主研发	FPGA 芯片	2016111162371
27	FPGA 配套开发软件	Procise	可编程器件开发工具软件	自主研发	FPGA 芯片	非专利技术
		一种 FPGA 总体布局合法化方法	可编程器件开发工具软件之布局功能	自主研发	FPGA 开发工具软件	201610914808X
		一种 FPGA 详细布局的模拟退火方法	可编程器件开发工具软件之布局功能	自主研发	FPGA 开发工具软件	2016110133545

序号	核心技术名称	主要用途	技术来源	应用产品	专利号/ 非专利技术
	一种基于解析方法的总体 FPGA 自动化布局方法	可编程器件开发工具软件之布局功能	自主研发	FPGA 开发工具软件	2017100195662
	可编程逻辑器件的 I/O 单元布局方法及装置、介质及设备	可编程器件开发工具软件之布局功能	自主研发	FPGA 开发工具软件	2017104478270
	一种基于查找表的 FPGA 芯片逻辑单元时延建模方法和系统	可编程器件开发工具软件之时序分析功能	自主研发	FPGA 开发工具软件	2017100997856
	一种 FPGA 芯片版图连线显示方法	可编程器件开发工具软件之版图显示功能	自主研发	FPGA 开发工具软件	非专利技术
	FPGA 的装箱方法及装置	可编程器件开发工具软件之装箱功能	自主研发	FPGA 开发工具软件	2016109491031
	时延评估方法及装置、可读存储介质	可编程器件开发工具软件之时序分析功能	自主研发	FPGA 开发工具软件	非专利技术
其他					
28	GFCI 断路器自检功能设计	GFCI 断路器的控制芯片	自主研发	GFCI 断路器	US10923899B2 US11258246B2 US11588317B2 2018102046686 2019103622273 2020106590347
29	故障电弧检测技术	故障电弧检测、消防报警	自主研发	AFD、AFDD、AFCI 断路器	2016107763281
30	隔离式直流电流检测	低压电器中 B 型剩余电流保护，充电桩漏电保护	自主研发	B 型剩余电流保护断路器	2020214598045

(三) 发行人主要经营和财务数据及指标

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总计	841,135.09	611,088.81	416,501.42
负债合计	244,964.91	95,771.87	79,811.16

归属于母公司所有者权益合计	530,297.62	453,123.04	314,024.57
所有者权益合计	596,170.18	515,316.94	336,690.25

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
营业总收入	353,625.94	353,890.89	257,726.23
营业总成本	281,591.74	236,425.18	204,534.71
营业利润	75,141.71	112,139.96	57,336.10
利润总额	75,185.09	112,151.07	57,344.95
净利润	74,885.87	111,726.48	55,932.47
归属于母公司所有者的净利润	71,949.44	107,684.33	51,446.68
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	57,249.22	101,940.55	44,420.31

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
经营活动产生的现金流量净额	-70,816.66	32,128.55	60,220.49
投资活动产生的现金流量净额	-73,159.68	-13,251.45	-118,279.73
筹资活动产生的现金流量净额	131,027.07	50,458.69	71,880.57
现金及现金等价物净增加额	-12,736.19	70,453.16	13,638.59
期末现金及现金等价物余额	99,292.50	112,028.69	41,575.53

4、主要财务指标

财务指标	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	3.16	4.79	4.27
速动比率（倍）	1.47	3.15	2.98
资产负债率（母公司）	31.61%	17.02%	19.32%
资产负债率（合并）	29.12%	15.67%	19.16%
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	6.47	5.55	3.86
财务指标	2023 年度	2022 年度	2021 年度
应收账款周转率（次）	4.16	5.82	5.55

存货周转率（次）		0.53	0.93	1.25
归属于发行人股东的净利润（万元）		71,949.44	107,684.33	51,446.68
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）		57,249.22	101,940.55	44,420.31
研发费用占营业收入的比例		28.58%	20.78%	26.84%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		-0.86	0.39	0.74
每股净现金流量（元/股）		-0.16	0.86	0.17
扣除非经常性损益前每股收益（元/股）	基本	0.88	1.32	0.69
	稀释	0.87	1.31	0.69
扣除非经常性损益前净资产收益率		14.68%	28.48%	20.77%
扣除非经常性损益后每股收益（元/股）	基本	0.70	1.25	0.60
	稀释	0.70	1.24	0.60
扣除非经常性损益后净资产收益率		11.68%	26.96%	17.93%

注：上述主要财务指标计算方法如下：

流动比率=期末流动资产 / 期末流动负债

速动比率=（期末流动资产-期末存货） / 期末流动负债

资产负债率=总负债/总资产

归属于发行人股东的每股净资产=期末净资产 / 期末总股本

应收账款周转率=营业收入 / 应收账款平均账面余额

存货周转率=营业成本/存货平均账面余额

研发费用占营业收入的比例=研发费用/营业收入

每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额 / 期末总股本

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加（或减少）额 / 期末总股本

基本每股收益= $P_0 \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k)$

（其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。）

稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

（其中： P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。）

加权平均净资产收益率= $P_0 / (E_0 + N_p \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

(其中： P_0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润； N_p 为归属于公司普通股股东的净利润； E_0 为归属于公司普通股股东的期初净资产； E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产； E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产； M_0 为报告期月份数； M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数； E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动； M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。)

(四) 发行人存在的主要风险

1、集成电路行业增速放缓及公司业绩下滑的风险

公司主要业务是集成电路设计业务，公司发展与下游行业发展高度相关。2022 年下半年以来，受到产能结构性缓解以及消化前期库存等因素影响，以消费电子产品为代表的部分芯片需求呈现下滑趋势；虽然公司产品线覆盖范围包括工业级产品、消费、高可靠等应用场景，抗波动能力较强，但如果出现行业性的增长放缓，可能对公司业绩造成不利影响。

2021 年至 2023 年，公司的营业收入分别为 257,726.23 万元、353,890.89 万元、**353,625.94 万元**，复合增长率达 **17.14%**；实现归属母公司股东的净利润为 51,446.68 万元、107,684.33 万元以及 **71,949.44 万元**，复合增长率达 **18.26%**。

2023 年，公司营业收入为 **353,625.94 万元**，同比下滑 **0.07%**；归属于母公司股东的净利润为 **71,949.44 万元**，同比下滑 **33.18%**。2023 年以来，全球经济增速下行，消费电子需求不振，半导体行业整体处于下行周期，相关因素导致公司营业收入增速有所放缓，同时为保持市场竞争力与核心技术的先进性，公司持续加强研发投入，综合影响下公司存在业绩下滑的风险。

2、国际贸易环境对公司经营影响较大的风险

近年来国际贸易环境不确定性增加，逆全球化贸易主义进一步蔓延，部分国家采取贸易保护政策，屡屡采取长臂管辖措施，对我国集成电路产业有所冲击。集成电路行业具有典型的全球化分工合作特点，若国际贸易环境发生重大不利变化、各国与各地区间贸易摩擦进一步升级、全球贸易保护主义持续升温，则可能对包括公司在内的集成电路产业链上下游公司的生产经营产生不利影响，造成产业链上下游交易成本增加，从而对公司的经营带来不利影响。

集成电路行业具有典型的全球化分工合作特点，公司本次募投项目所需的部分晶圆、开发设备及 IP 授权拟从中国大陆以外采购，若未来国际贸易政策发生重大不利变化，公司不能及时采取替代措施保障募投项目所需的材料、设备和 IP 授权的采购，或募投项目所对应主要产品的生产受到较大影响，募投项目研发进度以及效益实现存在不达预期的风险。

3、募集资金投资项目研发及实施风险

本次募集资金投资项目包括新一代 FPGA 平台开发及产业化项目、智能化可重构 SoC 平台开发及产业化项目、新工艺平台存储器开发及产业化项目、新型高端安全控制器开发及产业化项目和无源物联网基础芯片开发及产业化项目，募投项目的实施将对公司的发展战略和业绩水平产生重大影响。

公司本次募投项目投入较大，且建设期处于 2~4 年。考虑到公司所处的集成电路设计行业为典型的技术密集型行业，技术的升级与产品的迭代速度快；其中，高端芯片存在开发周期长、资金投入大、研发风险高的特点。因此，公司在研发过程中很可能存在因某些关键技术未能突破或者产品性能、参数、良率等无法满足市场需要而研发失败、落后于新一代技术的风险。

同时，虽然公司已对募投项目进行了慎重、充分的可行性研究论证，但该研究主要基于当前产业政策、市场环境和技术水平等因素作出。如果公司在后续研发过程中对市场需求判断失误或研发进度缓慢，或在项目实施过程中技术研发成果、投资成本等客观条件发生较大不利变化，则本次募集资金投资项目是否能够按时实施、研发产品是否能够成功上市并实现产业化将存在不确定性，将面临被竞争对手抢占市场份额的风险。

前述情况的发生均可能导致募投项目的实施效果不及预期，进而影响公司的盈利能力。

4、募集资金投资项目效益低于预期的风险

本次发行的募投项目拟使用募集资金金额合计达 20 亿元，本次募集资金投资项目的实施计划和实施进度系依据发行人及行业的过往经验制定，经济效益数据系依据可研报告编制当时的市场即时和历史价格以及相关成本等预测性信息

测算得出。

若项目在建设过程中出现不可控因素导致无法按预期进度建成，或项目建成后的市场环境发生不利变化导致行业竞争加剧、产品价格下滑、产品市场需求未保持同步协调发展，将可能导致募集资金投资项目产生效益的时间晚于预期或实际效益低于预期水平。

5、毛利率下降的风险

近年来，集成电路设计行业受到社会、市场和资本的关注度不断提高，竞争逐步加剧。国际方面，公司与同行业龙头企业相比，公司某些产品在产品布局的丰富程度、工艺制程与性能表现等技术指标的先进程度、经营规模或市场占有率的领先程度上存在较大差距；在国内方面，公司各条产品线所面对的竞争对手也在逐渐增多。2022年下半年以来，由于消费类电子下行，部分产品供求关系已经发生变化，行业整体的毛利率水平受到明显冲击。

报告期内，公司综合毛利率分别为 58.91%、64.67%以及 **61.21%**，**总体保持相对稳定**。随着同行业企业数量的增多及业务规模的扩大，市场竞争将日趋激烈，行业的供求关系可能将发生变化，导致行业整体利润率水平存在下降的风险。同时，若未来因技术水平进步、人工和原材料价格上涨以及公司产品议价能力下降，而公司不能采取有效措施以巩固和增强产品竞争力，公司综合毛利率也将面临持续下降的风险，进而造成公司在激烈的市场竞争中处于不利地位，降低持续盈利能力。

6、存货跌价风险

公司存货主要为芯片及晶圆，受芯片市场销售竞争日益加剧等因素影响，公司为保障供货需求，报告期内逐步扩大了备货规模。报告期各期末，公司存货账面价值分别为 91,608.31 万元、148,326.45 万元以及 **317,737.06 万元**，分别占对应期末流动资产总额的 30.12%、34.28%以及 **53.52%**。公司每年根据存货的可变现净值低于成本的金额计提相应的跌价准备，报告期各期末，公司存货跌价准备余额分别为 9,334.88 万元、20,775.92 万元以及 **28,667.46 万元**，存货跌价准备计提的比例分别为 9.25%、12.29%以及 **8.28%**。若未来市场需求发生变化、市场竞争加剧或由于技术迭代导致产品更新换代加快，可能导致存货跌价风险提高，

从而对公司经营业绩产生不利影响。

7、研发投入相关的财务风险

公司高度重视核心技术的自主研发，报告期各期，公司研发投入分别为 74,892.45 万元、88,610.18 万元和 **118,958.61 万元**，占营业收入的比例分别为 29.06%、25.04% 和 **33.64%**，始终处于较高水平。若开发支出形成的无形资产计提摊销，或开发支出出现撤销、无形资产出现减值等情形，可能将对公司的利润产生较大影响。

报告期各期末，公司的开发支出余额分别为 17,272.81 万元、31,652.17 万元以及 **45,610.86 万元**，占各期末非流动资产的比例分别为 15.38%、17.74% 以及 **18.44%**。如果公司内部或外部环境发生不利变化，可能对研发项目的正常推进或研发成果的产业化运用造成负面影响，从而导致公司面临相关无形资产较大的减值风险，并对公司未来业绩造成负面影响。

8、应收账款及应收票据回收的风险

报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为 46,901.23 万元、74,666.77 万元和 **95,343.30 万元**，应收票据账面余额分别为 37,933.50 万元、25,623.56 万元和 **39,853.67 万元**，应收账款与应收票据账面余额合计占当年度营业收入的比例为 32.92%、28.34% 和 **38.23%**。如果未来宏观经济形势、行业发展前景等因素发生不利变化，客户经营状况发生重大困难，公司可能面临应收账款及应收票据无法收回而增加坏账损失的风险。

二、发行人本次发行情况

（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该 A 股可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。

（二）发行规模

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行 A 股可转换公司债券总额不超过人民币 200,000.00 万元（含本数），

具体发行规模由公司股东大会及类别股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的 A 股可转换公司债券每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。

（四）债券期限

本次发行的 A 股可转换公司债券期限为自发行之日起六年。

（五）发行方式及发行对象

本次 A 股可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会及类别股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐人（主承销商）协商确定。本次 A 股可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（六）向原有 A 股股东配售的安排

本次发行的 A 股可转换公司债券向公司原有 A 股股东优先配售，原有 A 股股东有权放弃优先配售权。向原有 A 股股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定，并在本次发行的 A 股可转换公司债券的发行公告中予以披露。该等优先配售将须遵守《公司法》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》或任何其他政府或监管机构的所有适用法律、法规及规则（包括但不限于关联交易相关的规则和要求），方可落实。

公司原有 A 股股东优先配售之外的余额及原有 A 股股东放弃优先配售后部分采用网下对机构投资者发售及/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，具体发行方式由股东大会及类别股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐人（主承销商）在发行前协商确定。如仍出现认购不足，则不足部分由承销商包销。

三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他

成员情况、联系地址、电话和其他通讯方式

（一）本次证券发行的保荐代表人

中信建投证券指定赵凤滨、逯金才担任本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的保荐代表人。

上述两位保荐代表人的执业情况如下：

赵凤滨女士：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会执行总经理，曾主持或参与的项目有：三柏硕 IPO、长盈通 IPO、中国核建 IPO、中国电建 IPO、大豪科技 IPO、纽威股份 IPO、长城证券 IPO、金凯生科 IPO、华岭股份北交所上市、芭田股份非公开、炼石有色非公开、中国电建非公开、南方航空非公开、长城证券非公开、中国核建可转债、中国电建重大资产重组、置信电气重大资产重组、京投公司收购银泰股份、国电投公司债、中国电建公司债、中航国际公司债、国开投公司债等项目，作为保荐代表人现在尽职推荐的项目有：无。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

逯金才先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：沃尔德 IPO、长城证券 IPO、辰安科技 IPO、金凯生科 IPO、长城证券非公开、北方华创非公开、中国核建可转债、顾家家居可转债、东方网力非公开、置信电气重大资产重组、诚志股份重大资产重组、东方网力重大资产重组等项目，作为保荐代表人现在尽职推荐的项目有：无。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（二）本次证券发行项目协办人

本次证券发行项目的协办人为叶天翔，其保荐业务执行情况如下：

叶天翔先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾参与的项目有：中国核建 IPO、长城证券 IPO、复旦微电 IPO、华岭股份北交所上市、西藏旅游非公开、长城证券非公开等项目。在保荐业务执

业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（三）本次证券发行项目组其他成员

本次证券发行项目组其他成员包括于宏刚、闫文斌、庄志安、刘树帆。

于宏刚先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会董事总经理，曾主持或参与的项目有：复旦微电 IPO、中国电信 IPO、中国电建 IPO、中国国旅 IPO、兴源过滤 IPO、桂发祥 IPO、科锐国际 IPO、长城证券 IPO、筑博设计 IPO、中国核建 IPO、雷赛智能 IPO、三柏硕 IPO、华岭股份北交所上市、科锐国际向特定对象发行股票、中国电建非公开、西藏旅游非公开、长城证券非公开等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

闫文斌先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾参与的项目有：中国茶叶 IPO、金凯生科 IPO、航天长峰非公开、国电投公司债项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

庄志安先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾参与的项目有：三柏硕 IPO、长城证券非公开、置信电气重大资产重组、国机重装重新上市等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

刘树帆先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：长城证券 IPO、倍杰特 IPO、三柏硕 IPO、华岭股份北交所上市、长城证券非公开、诚志股份重大资产重组等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（四）联系地址、电话和其他通讯方式

保荐人（主承销商）：	中信建投证券股份有限公司
联系地址：	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 11 层

邮编：	100026
联系电话：	010-56051432
传真：	010-56160130

四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明

（一）保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其第一大股东、第二大股东、重要关联方股份的情况

截至 2024 年 3 月 25 日，中信建投证券全资子公司中信建投投资有限公司参与公司首次公开发行战略配售获得的限售股份为 6,000,000 股，占发行人本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券前股本比例为 0.73%。

此外，中信建投证券衍生品业务自营性质账户持有发行人 153,616 股股票，占发行人本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券前股本比例为 0.02%。保荐人买卖复旦微电股票的自营业务账户为指数化及量化投资业务账户，上述账户投资策略是基于交易所及上市公司发布的公开数据，通过量化模型发出股票交易指令。此类交易表现为一篮子股票组合的买卖，并不针对单只股票进行交易，属于通过自营交易账户进行的 ETF、LOF、组合投资、避险投资、量化投资等范畴，符合中国证券业协会《证券公司信息隔离墙制度指引》等规定。保荐人已经制定并执行信息隔离管理制度，在存在利益冲突的业务之间设置了隔离墙，防止内幕信息不当流通。综上所述，保荐人上述自营业务股票账户买卖复旦微电股票行为与复旦微电本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券不存在关联关系，保荐人不存在公开或泄漏相关信息的情形，也不存在利用该信息进行内幕交易或操纵市场的情形。

此外，中信建投证券衍生品业务自营性质账户持有发行人子公司华岭股份 35,077 股股票，占华岭股份总股本比例为 0.01%。

除上述情况外，保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其第一大股东、第二大股东、重要关联方股份的情况。保荐人已建立有效的信息隔离墙管理制度，保荐人上述持有发行人或其第一大股东、第二大股东、

重要关联方股份的情形不影响保荐人及保荐代表人公正履行保荐职责。

(二) 发行人或其第一大股东、第二大股东、重要关联方不存在持有保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

(三) 保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在持有发行人或其第一大股东、第二大股东及重要关联方股份，以及在发行人或其第一大股东、第二大股东及重要关联方任职的情况

(四) 保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人第一大股东、第二大股东、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况；

(五) 保荐人与发行人之间不存在其他关联关系。

五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项

保荐人已按照法律法规和中国证监会及上交所相关规定，对发行人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，中信建投证券作出以下承诺：

(一) 有充分理由确信发行人符合法律法规和中国证监会及上交所有关证券发行上市的相关规定；

(二) 有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

(三) 有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

(四) 有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

(五) 保证所指定的保荐代表人及本保荐人的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

(六) 保证上市保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏；

（七）保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

（八）自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；

（九）中国证监会、上交所规定的其他事项。

中信建投证券承诺，将遵守法律、行政法规和中国证监会、上交所对推荐证券上市的规定，自愿接受上交所的自律监管。

六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明

公司第九届董事会第九次会议于 2023 年 4 月 28 日召开，审议并通过了《关于公司符合向不特定对象发行 A 股可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》等关于本次发行可转债的相关议案。

公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会于 2023 年 7 月 5 日召开，审议并通过了《关于公司符合向不特定对象发行 A 股可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》等关于本次发行可转债的相关议案。

本次发行**已经上交所审核通过**，尚需中国证监会注册后方可实施。

综上，发行人已就本次证券发行履行了《公司法》《证券法》及中国证监会以及上海证券交易所的有关业务规则规定的决策程序。

七、保荐人关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程

（一）核查内容及过程

1、查阅了《产业结构调整指导目录（2019年本）》《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等业务规则及产业政策；

2、查阅了公司年度报告、核心技术相关专利证明文件、本次募集资金投资项目的可行性研究报告；

3、访谈发行人管理层，了解发行人产品技术路线、技术水平、本次募投项目情况。

（二）核查结论

本次向不特定对象发行A股可转换公司债券的募集资金投资项目为新一代FPGA平台开发及产业化项目、智能化可重构SoC平台开发及产业化项目、新工艺平台存储器开发及产业化项目、新型高端安全控制器开发及产业化项目和无源物联网基础芯片开发及产业化项目，资金投向围绕主营业务进行。

集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业。本次募集资金投向是在现有主营业务的基础上，结合市场需求和未来发展趋势，加大对公司集成电路核心业务领域重点产品及重要研究方向实施的投资，项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》“鼓励类”范畴；根据国务院2020年发布的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。根据国家发改委、工信部等六部2020年发布的《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》，对国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业减免企业所得税。

根据全国人大 2021 年通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，要培育先进制造业集群，推动集成电路等产业创新发展。本次募集资金投向于集成电路行业，与国家产业政策一致。

综上，发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投向围绕科技创新领域开展，本次证券发行符合国家产业政策。

八、持续督导期间的工作安排

持续督导事项	具体安排
1、督促上市公司建立和执行信息披露、规范运作、承诺履行、分红回报等制度	1、协助和督促上市公司建立相应的内部制度、决策程序及内控机制，以符合法律法规和上市规则的要求； 2、确保上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员、核心技术人员知晓其各项义务； 3、督促上市公司积极回报投资者，建立健全并有效执行符合公司发展阶段的现金分红和股份回购制度； 4、持续关注上市公司对信息披露、规范运作、承诺履行、分红回报等制度的执行情况。
2、识别并督促上市公司披露对公司持续经营能力、核心竞争力或者控制权稳定有重大不利影响的风险或者负面事项，并发表意见	1、持续关注上市公司运作，对上市公司及其业务充分了解； 2、关注主要原材料供应或者产品销售是否出现重大不利变化；关注核心技术人员稳定性；关注核心知识产权、特许经营权或者核心技术许可情况；关注主要产品研发进展；关注核心竞争力的保持情况及其他竞争者的竞争情况； 3、关注第一大股东、第二大股东所持上市公司股权被质押、冻结情况； 4、核实上市公司重大风险披露是否真实、准确、完整。
3、关注上市公司股票交易异常波动情况，督促上市公司按照上市规则规定履行核查、信息披露等义务	1、通过日常沟通、定期回访、调阅资料、列席股东大会等方式，关注上市公司日常经营和股票交易情况，有效识别并督促上市公司披露重大风险或者重大负面事项； 2、关注上市公司股票交易情况，若存在异常波动情况，督促上市公司按照交易所规定履行核查、信息披露等义务。
4、对上市公司存在的可能严重影响公司或者投资者合法权益的事项开展专项核查，并出具现场核查报告	1、上市公司出现下列情形之一的，自知道或者应当知道之日起 15 日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项； 2、就核查情况、提请上市公司及投资者关注的问题、本次现场核查结论等事项出具现场核查报告，并在现场核查结束后 15 个交易日内披露。
5、定期出具并披露持	1、在上市公司年度报告、半年度报告披露之日起 15 个交易日内，

持续督导事项	具体安排
持续督导跟踪报告	披露持续督导跟踪报告； 2、上市公司未实现盈利、业绩由盈转亏、营业收入与上年同期相比下降 50% 以上或者其他主要财务指标异常的，在持续督导跟踪报告显著位置就上市公司是否存在重大风险发表结论性意见。
6、出具保荐总结报告书	持续督导工作结束后，在上市公司年度报告披露之日起的 10 个交易日内依据中国证监会和上海证券交易所相关规定，向中国证监会和上海证券交易所报送保荐总结报告书并披露。
7、持续督导期限	在本次发行结束当年的剩余时间以及以后 2 个完整会计年度内对发行人进行持续督导。

九、保荐人认为应当说明的其他事项

无。

十、保荐人关于本项目的推荐结论

本次发行申请符合法律法规和中国证监会及上交所的相关规定。保荐人已按照法律法规和中国证监会及上交所相关规定，对发行人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序并具备相应的保荐工作底稿支持。

保荐人认为：本次上海复旦微电子集团股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会及上交所有关规定；中信建投证券同意作为本次上海复旦微电子集团股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的保荐人，并承担保荐人的相应责任。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于上海复旦微电子集团股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券之上市保荐书》之签字盖章页)

项目协办人签名: 叶天翔

叶天翔

保荐代表人签名: 赵凤滨 逯金才

赵凤滨

逯金才

内核负责人签名: 张耀坤

张耀坤

保荐业务负责人签名: 刘乃生

刘乃生

法定代表人/董事长签名: 王常青

王常青

